



## Tagesordnung

Thema: **01. Treffen des Arbeitskreises EcoReliability**  
„Zuverlässige und nachhaltige Elektronik“

Datum: **28. März 2024 10:00 -13:00 Uhr**

Ort: Hybrid (Fraunhofer IZM & MS TEAMS)

### Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr  
**Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung**  
*Herr Wagner, Frau Kolbinger, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 2 10:10 Uhr  
**Recap Auftaktveranstaltung vom 20.11.2024**  
*Frau Kolbinger, Herr Eckstein, Herr Walter, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 3 10:20 Uhr  
**Fachvortrag: Life cycle assessment in 3D chip integration**  
*Frau Billaud, CEA-Leti*
- 4 11:00 Uhr  
**Fachvortrag: Einflüsse der Bohrlochqualität auf die Schadensentwicklung in Kupfer-Durchkontaktierungen in PCBs**  
*Frau Conrad, TU Berlin*
- 5 11:40 Uhr  
**Fachvortrag: Using  $\mu$ -Raman spectroscopy to inspect sintered interconnects**  
*Herr Elger, Technische Hochschule Ingolstadt*
- 6 12:20  
**Impulsvortrag**
- 7 12:45  
**Abschlussdiskussion**
- 8 13:00  
**Lab-Tour für alle Präsenzteilnehmer**

**Ende der Veranstaltung gegen 13:30 Uhr**